



芯片厂商联发科技瞄准3G发牌商机

2009-01-23 | 编辑: | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

受全球金融风暴波及等因素影响，一些TD-SCDMA（以下简称“TD”）企业曾公开表示，今年将缩减在TD上的研发投入。峰回路转，新年的第一个星期，工业和信息化部向三大电信运营商正式发放了3G牌照。3G时代开启的同时，TD企业间新一轮的竞争就此拉开序幕。

技术更新应对金融危机

面对金融危机，TD终端芯片供应商联发科技也同样承受压力。尽管如此，去年12月初，该公司新闻发言人喻铭铎在接受媒体采访时仍然表示，TD仍是2009年联发科技研发工作的重中之重。

在联发科技看来，现在的市场份额领先其实没有太多意义，公司更加看重的是技术上的不断突破。此外，TD是个大事业，不能只以生意的眼光来衡量得失，产业的发展常常不取决于企业的意愿，当企业决定涉足时，就要对各种可能出现的情况做好财务层面、公司运营层面以及心理承受层面的充分准备。

“此次全球金融风暴对于每个企业都会有影响，但研发是IC设计公司的根本。”喻铭铎当时强调，不管外界环境如何，该做的产品还得做，该投入的研发仍然要投入，对于重点的产品更要加大投入。

实际上，早在2005年，联发科技就开始关注TD领域。虽然在光存储芯片领域已是全球第一，但该公司当时在手机芯片领域才刚刚崭露头角。2006年，也是岁末年初的时候，联发科技高层在一次与内地媒体的会面中表示，TD是中国通信行业第一个自有知识产权的行业标准，它的发展有自己的规律，不一定非得走得很快，或许还需要两年左右的时间，这是联发科技第一次公开对TD业务表态。

一年突破两大技术难题

一年之后，联发科技迎来了转折点。2007年9月，联发科技宣布并购ADI手机芯片业务。不过，由于“ADI/大唐”组合是当时产业中领先的TD终端芯片供应商，因此联发科技的此次并购招来了诸多非议、有人甚至喊出了“联发科技在抢夺TD胜利果实”、“联发科技将毁了TD”等等煽动性言论。

“并购ADI手机芯片业务，TD固然是其中重要的考虑因素，但并购案能为联发科技未来成长为一家真正的国际化IC公司带来重要驱动力，也是同样重要的因素。”联发科技并没有理会满天飞的流言，宣布并购次日，联发科技与大唐移动发表联合声明，表示将尽最大努力维护TD产业链的稳定。

- ▣ 科普首页
- ▣ 微电子历史
- ▣ 行业动态
- ▣ 术语解释
- ▣ 无微不至
- ▣ 芯片制程
- ▣ 科普创意



去年以来，联发科技先后“拿下”TD-HSDPA和TD-HSUPA两个产业技术难题，在中国移动前两期TD终端招标中，采用“联芯/联发科技”芯片方案（联发科技提供芯片硬件、联芯提供软件平台）的终端产品超过五成。“联芯/联发科技”不仅再次证明了自己仍然是TD终端芯片领域中最为领先的供应商，同时也带动了中兴通讯、希姆通等合作伙伴的共同成长。

国产标准加速进军海外市场 “如果说此前试商用阶段对于TD企业来说是‘演习’，那么3G牌照发放后就是真刀真枪的较量了。”当被问及3G牌照发放对于TD产业链的作用和意义时，喻铭铎表示，3G牌照的发放必将在更大程度上激发产业链中各企业的能力和潜质，从而推动产业技术、服务及商业模式的发展和成熟，有利于进一步提升TD-SCDMA产业链的整体竞争力。

据介绍，联发科技今年将继续支持TD的发展，在整个产业链最为关键的TD核心芯片方面提高集成度和半导体工艺设计，并推动TD技术走向国际市场。按照预计，该公司在TD芯片领域的最新研发成果——TD射频单芯片，将在今年上半年配合客户产品上市，该芯片将支持TD双频段技术。此前，联发科技推出的TD-HSDPA芯片已经具备完整套片批量供货的能力，使用该芯片的终端产品已经面市；在TD-HSUPA芯片方面，终端产品也将在今年上半年面市。

在联发科技看来，从3G牌照发放到3G手机放量式增长，这中间仍然至少有6-12个月的时间。企业的技术能力、资源调配能力、管理能力都将在这期间经受重要考验。考验的结果则将直接关系到未来中国3G市场的格局。喻铭铎表示，公司将在技术上支持客户做好“最后的冲刺”。

（来源：北京商报 2009年1月24日）



中国科学院微电子研究所版权所有 邮编：100029

单位地址：北京市朝阳区北土城西路3号，电子邮件：webadmin@ime.ac.cn

京公网安备110402500036号